



TIF® 100N-25-16S 系列热传导界面材料专为填充发热器件与散热片或金属底座之间的空气间隙而设计。具备良好的柔顺性，能够紧密贴合不同形状和高度差异的热源,即使在狭小或不规则空间内也具有稳定导热性，从分离器件或整个 PCB 传输至金属外壳或散热板，显著提升电子组件的散热效率，从而增强设备运行稳定性并延长使用寿命。

特性

- 》良好的热传导率: 2.5W/mK
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

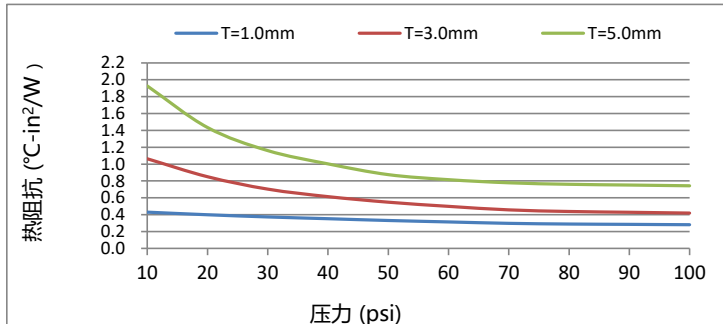
应用

- 》散热器底部或框架
- 》显卡模组
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》LED电视、灯具

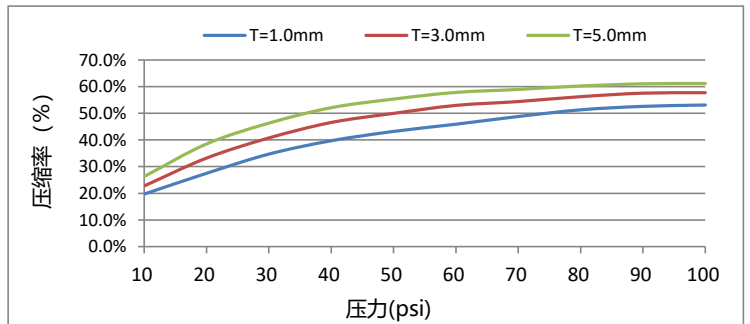
TIF® 100N-25-16S 系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	蓝紫色	目视
结构&成份	氮化硼填充硅橡胶	-
厚度范围 (inch/mm)	0.02~0.20 0.50~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	45	ASTM D2240
密度 (g/cc)	1.6	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200	-
击穿电压 (V/mm)	≥5500	ASTM D149
介电常数 @1MHz	2.8	ASTM D150
导热系数 (W/mK)	2.5	ASTM D5470
	2.5	ISO22007-2
阻燃等级	V-0	UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.02~0.20 inch (0.5~5.0mm) 以 0.01 inch (0.25mm) 为增量。

标准尺寸: 16" × 16" (406mm × 406mm)。

零件编码:

涂层处理: NS1 (无粘性涂层)、DC1 (单面加硬)。

胶层处理: A1/A2 (单面/双面带胶黏剂)。

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

